(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年7月20日(20.07.2023)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2023/136057 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2022/046952

(22) 国際出願日： 2022年12月20日(20.12.2022)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2022-002313 2022年1月11日(11.01.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目１３番９号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 黒田 孝博 (**KURODA Takahiro**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 板垣 圭 (**ITAGAKI Kei**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 谷口 紘平 (**TANIGUCHI Kohei**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 守谷 研耶 (**MORIYA Kenya**); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

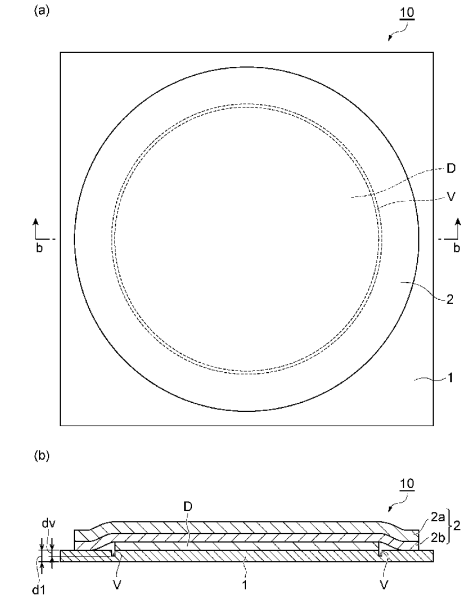
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (**HASEGAWA Yoshiki et al.**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号丸の内 ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,

(54) **Title:** INTEGRATED DICING/DIE BONDING FILM, METHOD FOR PRODUCING SAME, AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称： ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム及びその製造方法、並びに半導体装置の製造方法

[図1]



(57) **Abstract:** The present invention discloses an integrated dicing/die bonding film. This integrated dicing/die bonding film sequentially comprises a first base material layer, a die bonding film that contains conductive particles, an adhesive layer and a second base material layer in this order. The first base material layer has a cut part in the die bonding film-side surface, the cur part being formed along the outer periphery of the die bonding film. The maximum value of the peel strength at 30 ° of the die bonding film with respect to the first base material layer is 0.50 N/20 mm or less as measured at 25℃.

(57) 要約：ダイシング・ダイボンディング一体型フィルムが開示される。当該ダイシング・ダイボンディング一体型フィルムは、第１の基材層と、導電性粒子を含有するダイボンディングフィルムと、粘着剤層と、第２の基材層とをこの順に備える。第１の基材層は、ダイボンディングフィルム側の表面に、ダイボンディングフィルムの外縁に沿って設けられた切り込み部を有する。２５℃で測定される、第１の基材層に対するダイボンディングフィルムの３０° ピール強度の最大値は、０．５０Ｎ／２０ｍｍ以下である。

WO 2023/136057 A1

［続葉有］

MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))